







Умовне позначення отворів	Діаметр, мм	ДІаметр зінковки, мм	Наявність металізації	Розмір контактної площадки, мм	Кількість, шт	
0	1.3	1.4	Τακ	1.8	4	
0	1	1. 1	Τακ	1.5	18	
0	0.8	0.9	Τακ	1.6	22	
0	0.8	0.9	Τακ	1	12	

- * Розміри для довідок
- 2. Плату виготовити комбінованим нагетивним методом офсетного друку.
- 3. Плата повинна відповідати ОСТ 4.077.000-75
- 4. Крок кординатної сітки 0,5 мм.
- 5. Координацію провідників витримувати по координатній сітці з відхиленням від креслення 0.1 мм.
- б. Форма контактних площинок вільна.
- 7. Μαρκувати φαρδοю ΜΚΕΕ δίλα ΟCT 4.054.205 T 1.
- 8. В якості підкладок використовувати склотекстоліт СФ 2-35-1,5, товщиною 1,5 мм.

					ΦΚΙΣΙΤ 171.01	16	. <i>0</i>	2	4.0	01	
						///	тер	a /	Маса	Масшто	
		№ Документу	Підпис	Дата	Таймер						
	,	Розумнюк К. С.								4:1	
Пер	ревірив	Савченко М. Г.			Плата друкована						
Τ	Конт.				· -		Лисп	7 1	Ли	стів 1	
					Склотекстоліт						
		Домрачев О. М.			<i>ΓΦ 2-35-1,5</i>	1 / 4 / 7				!	
Зат	пвердив	Савченко М. Г.			LΨ Z-33-1,3						

Формат А1